



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

⑪ Número de publicación: **2 322 734**

⑫ Número de solicitud: 200602078

⑬ Int. Cl.:
E04F 15/02 (2006.01)
E01C 5/22 (2006.01)

⑫

PATENTE DE INVENCION

B1

⑭ Fecha de presentación: **01.08.2006**

⑮ Fecha de publicación de la solicitud: **25.06.2009**

Fecha de la concesión: **22.03.2010**

⑰ Fecha de anuncio de la concesión: **07.04.2010**

⑱ Fecha de publicación del folleto de la patente:
07.04.2010

⑲ Titular/es: **CERÁMICAS DEL FOIX, S.A.**
Avda. del Països Catalans, 27
Polígono Industrial Casanova
08730 Sta. Margarida i els Monjos, Barcelona, ES

⑳ Inventor/es: **García Calvo, José Luis**

㉑ Agente: **Ponti Sales, Adelaida**

㉒ Título: **Panel modular de pavimentación.**

㉓ Resumen:

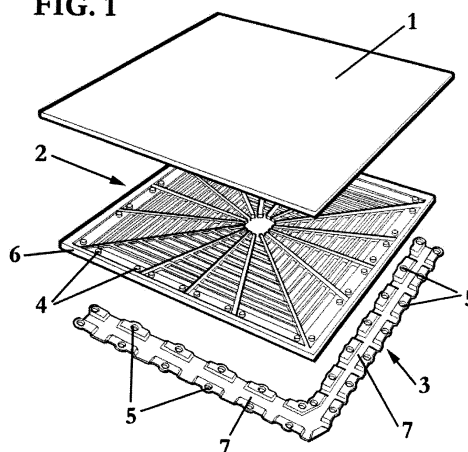
Panel modular de pavimentación.

El panel modular de pavimentación comprende una baldosa (1) y una base (2) unidas entre sí, comprendiendo dicha base (2) unos medios de acoplamiento (4), y se caracteriza por el hecho de que también comprende una regleta (3), que se coloca sobre el suelo que se ha de pavimentar, provista de medios de acoplamiento (5) complementarios a los medios de acoplamiento (4) de dicha base (2).

Preferiblemente, dicha base (2) comprende una pluralidad de salientes (4) que se alojan en una pluralidad de orificios (5) previstos en dicha regleta (3), o viceversa.

Gracias a la presencia de dicha regleta, es posible retirar una baldosa con su base correspondiente sin la necesidad de retirar el resto de baldosas, es decir, los paneles modulares son practicables.

FIG. 1



ES 2 322 734 B1

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.

DESCRIPCIÓN

Panel modular de pavimentación.

5 La presente invención se refiere a un panel modular de pavimentación, cuya colocación se realiza a presión y sin la utilización de cemento o colas de fijación.

Antecedentes de la invención

10 Son conocidos diferentes sistemas de pavimentación con baldosas sin la utilización de cemento o colas de fijación. En estos sistemas conocidos, cada panel modular de pavimentación comprende una base fijada a una baldosa provista de medios de acoplamiento a presión.

15 Por ejemplo, algunos de estos sistemas de pavimentación se describen en los documentos WO 2005/124053 y WO 99/049152.

20 La solicitud de patente WO 2005/124053 describe un panel modular compuesto por una baldosa y una base unidas entre sí. La base comprende unos salientes y entrantes complementarios con los salientes y entrantes de la base del panel adyacente.

Para realizar el acoplamiento entre dos paneles adyacentes es necesario empujar lateralmente uno de dichos paneles contra el otro.

25 El inconveniente que presenta este sistema de pavimentación es que los paneles modulares no son practicables, es decir, no puede retirarse un panel sin retirar previamente los colocados previamente en el momento de la pavimentación. Esto es debido a que el acoplamiento entre los diferentes paneles es lateral.

30 Además, en este sistema de pavimentación conocido, cada baldosa está rodeada por una junta solamente en dos de sus laterales, de manera que, una vez colocadas, está en contacto la junta con la baldosa. Esto implica que es necesario rectificar la baldosa durante su fabricación, como las baldosas convencionales.

Descripción de la invención

35 Con el panel modular de pavimentación de la invención se consiguen resolver los inconvenientes citados, presentando otras ventajas que se describirán.

40 El panel modular de pavimentación de la presente invención comprende una baldosa y una base unidas entre sí, comprendiendo dicha base unos medios de acoplamiento, y se caracteriza por el hecho de que también comprende una regleta, que se coloca sobre el suelo que se ha de pavimentar, provista de medios de acoplamiento complementarios a los medios de acoplamiento de dicha base.

45 Gracias a la presencia de dicha regleta, es posible retirar una baldosa con su base correspondiente sin ser necesaria la retirada del resto de baldosas, es decir, los paneles modulares son practicables. Esto es debido a que el acoplamiento entre la base y la regleta se realiza en vertical, es decir, se aplica una fuerza vertical para su acoplamiento o para su retirada. Tal como se ha indicado anteriormente, en los sistemas de pavimentación conocidos actualmente el acoplamiento entre los paneles se realiza horizontalmente, es decir, es necesario aplicar una fuerza lateral para acoplar o desacoplar los paneles.

50 Según una realización preferida, dicha base comprende una pluralidad de salientes que se alojan en una pluralidad de orificios previstos en dicha regleta, o viceversa.

Preferentemente, la regleta está formada por dos tramos perpendiculares entre sí. De esta manera, la base de un panel también se acoplará sobre la regleta de los paneles adyacentes.

55 Ventajosamente, dicha base comprende una junta en todo su perímetro, que preferiblemente presenta dos espesores diferentes, es decir, dicha junta define un contenedor donde se aloja la baldosa.

60 De esta manera, al colocarse los paneles en posición la unión entre los mismos es mediante el contacto entre las juntas, lo que permite asegurar la estanqueidad adecuada de la unión y jugar con las diferencias de las medidas, sin ser necesaria la rectificación de las baldosas durante su proceso de fabricación. Además, la presencia de la junta alrededor de toda la baldosa permite utilizar baldosas rústicas, es decir, con relieve.

65 Ventajosamente, dicha regleta comprende una ranura, a través de la cual puede pasar un cable sin que se pueda ver desde el exterior y sin realizar ningún tipo de obra. Dicha ranura está preferiblemente definida entre dos filas de orificios o salientes.

Breve descripción de los dibujos

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto se acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso práctico de realización.

La figura 1 es una vista en perspectiva en despiece de un panel modular de pavimentación de la presente invención, formado por una baldosa, una base y una regleta;

La figura 2 es una vista en perspectiva de un panel modular de pavimentación según la presente invención acoplado;

La figura 3 es una vista en perspectiva de tres paneles modulares acoplados entre sí y un panel modular separado del resto; y

La figura 4 es una vista en perspectiva de un detalle de la regleta de acoplamiento.

Descripción de una realización preferida

Tal como se puede apreciar en las figuras, el panel modular de pavimentación de la presente invención comprende una baldosa 1, una base 2 y una regleta 3. La baldosa 1 está fijada a la base 2 de manera convencional.

La base 2 es de material plástico y comprende medios de acoplamiento a la regleta 3. En la realización representada en las figuras dichos medios de acoplamiento están formados por una pluralidad de salientes 4 que se alojan en el interior de unos orificios 5 previstos en la regleta 3, o viceversa, es decir, los salientes en la regleta y los orificios en la base. Debe indicarse que no es imprescindible que dichos medios de acoplamiento estén formados por salientes complementarios a unos orificios, sino que podrían ser cualesquiera medios adecuados para acoplarse en vertical.

La base 2 también comprende una junta 6 que se extiende a lo largo de todo su perímetro, de manera que rodea completamente a dicha baldosa 1, es decir, dicha junta 6 define un contenedor donde se aloja la baldosa 1.

Dicha junta 6 presenta dos espesores diferentes, que permiten jugar con las medidas de la baldosa 1, de manera que no sea necesario rectificarla durante su fabricación.

Tal como se ha indicado anteriormente, la unión entre los paneles modulares adyacentes se realiza entre las juntas 6, y no mediante el contacto de una junta con la baldosa, como en los sistemas de pavimentación conocidos.

Por su parte, la regleta 3, que también es de plástico, está formada por dos tramos perpendiculares entre sí, tal como se puede apreciar en la figura 1.

En la realización representada, cada regleta 3 comprende dos filas de orificios 5 separados por una ranura 7. De dichas dos filas de orificios 5, la fila interior se utiliza para el acoplamiento de la base 2 que se coloca sobre los dos tramos de la regleta 3, y la fila exterior se utiliza para el acoplamiento de una base adyacente, tal como se puede apreciar en la figura 3. Dicha ranura 7 se puede utilizar, si se desea, para pasar un cable 8 (figura 4), sin necesidad de realizar ningún tipo de obra y sin que pueda verse exteriormente.

Para realizar la pavimentación de un suelo con los paneles modulares de la presente invención en primer lugar se coloca un primer panel sobre el suelo sin la utilización de ningún tipo de cola de fijación o cemento.

El panel modular de la presente invención se proporciona de fábrica con la base 2 unida a la baldosa 1, y preferiblemente con una regleta 3 acoplada a dicha base 2, es decir, tal como se representa en la figura 2.

Una vez colocado el primer panel modular sobre el suelo, se acoplarán sobre la parte de la regleta que queda a la vista dos paneles modulares adicionales, y así sucesivamente hasta cubrir la totalidad del suelo que se desea pavimentar, tal como se puede apreciar en la figura 3.

Para ajustar las medidas del panel al espacio disponible, los paneles pueden cortarse fácilmente con herramientas convencionales utilizadas actualmente para el corte de baldosas de cerámica. La base y la regleta también pueden cortarse fácilmente, ya que son de plástico.

A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es evidente para un experto en la materia que el panel modular de pavimentación descrito es susceptible de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles mencionados pueden ser substituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas.

REIVINDICACIONES

5 1. Panel modular de pavimentación, que comprende una baldosa (1) y una base (2) unidas entre sí, comprendiendo dicha base (2) unos medios de acoplamiento (4), **caracterizado** por el hecho de que también comprende una regleta (3), que se coloca sobre el suelo que se ha de pavimentar, provista de medios de acoplamiento (5) complementarios a los medios de acoplamiento (4) de dicha base (2).

10 2. Panel modular según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que dicha base (2) comprende una pluralidad de salientes (4) que se alojan en una pluralidad de orificios (5) previstos en dicha regleta (3), o viceversa.

3. Panel modular según la reivindicación 1 ó 2, **caracterizado** por el hecho de que la regleta (3) está formada por dos tramos perpendiculares entre sí.

15 4. Panel modular según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que dicha base (2) comprende una junta (6) en todo su perímetro.

20 5. Panel modular según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que dicha regleta (3) comprende una ranura (7).

6. Panel modular según las reivindicaciones 2 y 5, **caracterizado** por el hecho de que dicha ranura (7) está definida entre dos filas de orificios (5) o salientes.

FIG. 1

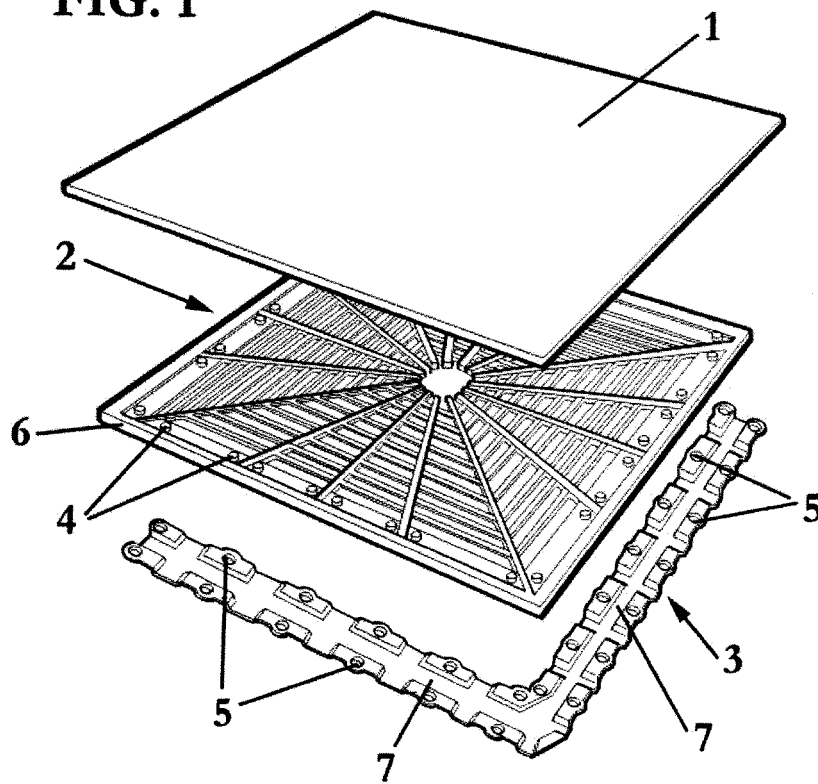
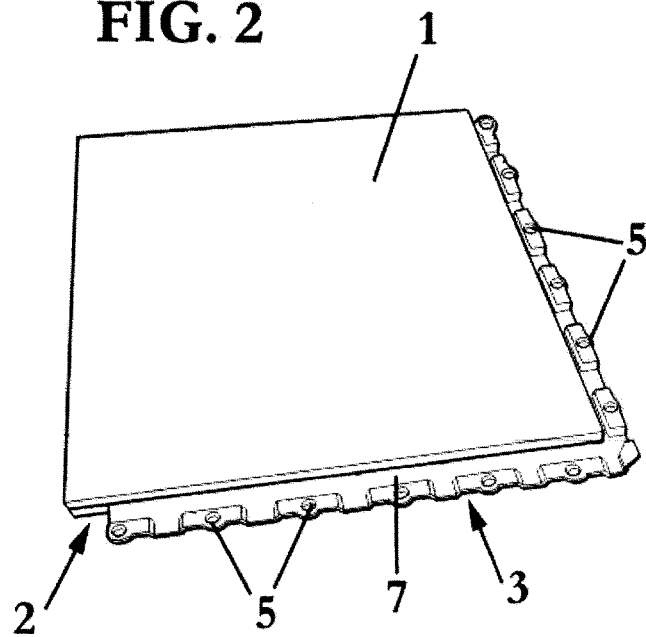
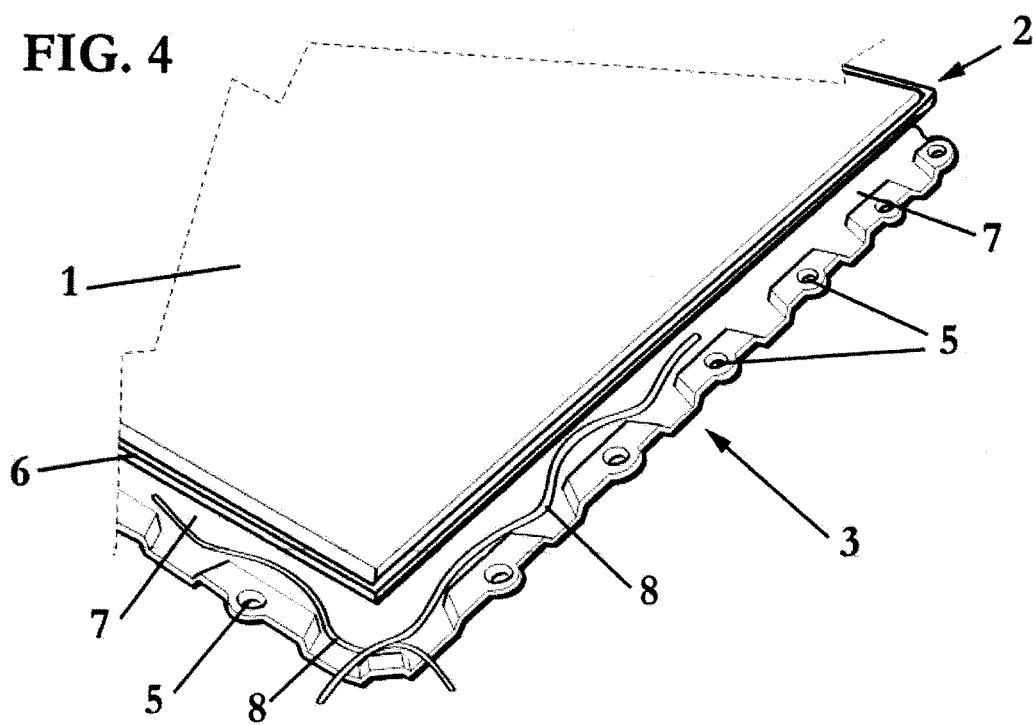
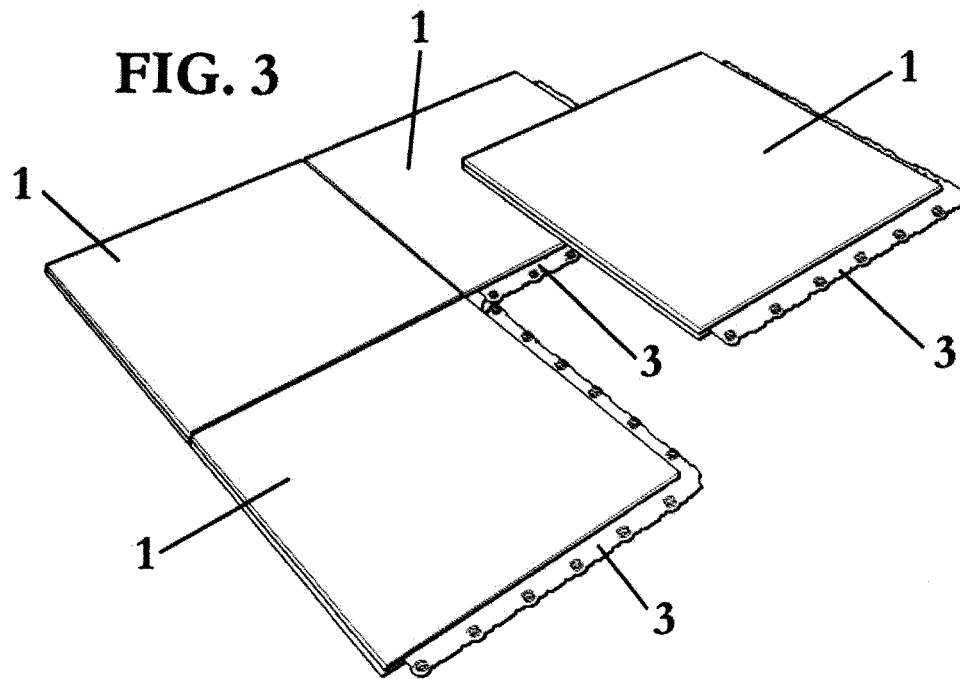


FIG. 2







OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

⑪ ES 2 322 734

⑫ Nº de solicitud: 200602078

⑬ Fecha de presentación de la solicitud: **01.08.2006**

⑭ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

⑮ Int. Cl.: **E04F 15/02** (2006.01)
E01C 5/22 (2006.01)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	⑯ Documentos citados	Reivindicaciones afectadas
X	US 2005144875 A1 (LENHARD-BACKHAUS et al.) 07.07.2005, párrafos [0016],[0020],[0022],[0025]; figura 1; resumen.	1-3,5,6
Y	EP 0191868 A1 (SAAMI CO LTD) 27.08.1986, página 2; resumen; figuras 1-4,10-14.	1-3
Y	US 2005210809 A1 (NEVISON et al.) 29.09.2005, párrafos [0004-0005],[0021-0023]; resumen; figura 2.	1-3
A	EP 1788166 A2 (INSCA INT SL) 23.05.2007, párrafos [0021-0023]; resumen; figuras.	1,3-6
A	WO 9941814 A1 (INTERFACE INC; SCOTT GRAHAM; OAKLEY DAVID D) 19.08.1999, todo el documento.	1,3,4

Categoría de los documentos citados

X: de particular relevancia

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría

A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita

P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud

E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

☒ para todas las reivindicaciones

☐ para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe
09.06.2009

Examinador
E. Balsera Porris

Página
1/1